

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 4 月 21 日 (21.04.2005)

PCT

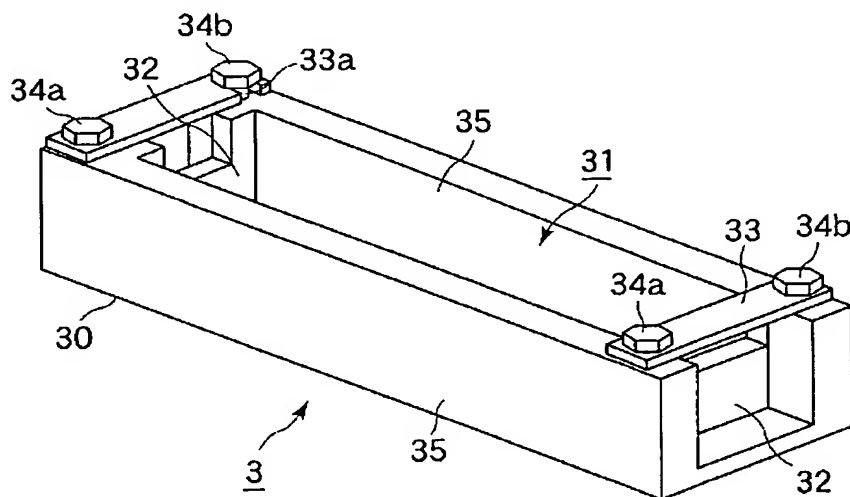
(10) 国際公開番号
WO 2005/036135 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01N 1/32, 1/28 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/012953 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 及川 雅之 (OIKAWA, Masayuki) [JP/JP]. 安倍 勝彦 (ANBAI, Katsuhiko) [JP/JP]. 高橋 信博 (TAKAHASHI, Nobuhiro) [JP/JP]. 林 輝幸 (HAYASHI, Teruyuki) [JP/JP].
(22) 国際出願日: 2004 年 9 月 6 日 (06.09.2004) (74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE, Takehiko et al.); 〒1000013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 7 番 2 号 鈴榮特許総合法律事務所内 Tokyo (JP).
(25) 国際出願の言語: 日本語 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 特願2003-349892 2003 年 10 月 8 日 (08.10.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目 3 番 6 号 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: INSPECTION METHOD AND INSPECTION ASSISTING DEVICE OF QUARTZ PRODUCT IN SEMICONDUCTOR PROCESSING SYSTEM

(54) 発明の名称: 半導体処理装置の石英製品の検査方法及び検査補助デバイス



(57) Abstract: An inspection assisting device (3) being employed in an inspection for identifying metallic impurities contained in an inspection object part by touching the inspection object part of a quartz rod-like member (21) in a semiconductor processing system to a processing liquid composed of an etching liquid and then analyzing the processing liquid. The rod-like member (21) has a pair of recesses (22) located while holding the inspection object part between them. The inspection assisting device (3) comprises a pair of end plates (32) engaging with the pair of recesses, a frame (30) for connecting the pair of end plates, and a liquid receiving part (31) arranged between the pair of end plates. The liquid receiving part (31) has dimensions sufficient for storing the processing liquid and touching the inspection object part to the processing liquid.

[続葉有]

WO 2005/036135 A1



(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約: 検査補助デバイス(3)は、半導体処理装置の石英製棒状部材(21)の検査対象部をエッチング液からなる処理液に接触させ、次に処理液を分析して検査対象部中に含まれる金属不純物を同定する検査に用いる。棒状部材(21)は検査対象部を挟んで位置する1対の凹部(22)を有する。検査補助デバイス(3)は、1対の凹部と係合する1対の端板(32)と、1対の端板を接続するフレーム(30)と、1対の端板間に配設された液受け部(31)と、を有する。液受け部(31)は、処理液を貯留すると共に、検査対象部を処理液に接触させる寸法を有する。